

令和2年度沖縄国際物流拠点等活用推進事業の成果概要

事業実施主体	株式会社ADO
プロジェクト名	沖縄から世界の半導体産業を支える～AI/IoT時代の最新型半導体を製造するフッ素樹脂フィルムを使用した高洗浄度バルブ用ダイヤフラムの量産化プロジェクト
事業内容	AI/IoT時代に対応する最先端の半導体製造プロセスでは、nm（ナノメートル）のゴミが問題となる段階である。世界初の成形品のフッ素樹脂フィルムを使用した「高洗浄度の次世代型バルブ」の試作品開発に成功し、本プロジェクトでは最終製品の開発と量産設備を用いた量産化対応を行う。
今後の計画	2021年度(令和3年度)：国内 サンプル出荷・初回生産品出荷 2022年度(令和4年度)：国内 12万台出荷(月産1万台) 2023年度(令和5年度)：国内 24万台出荷(月産2万台)
最終目標と現状	最終目標) 2025年度(令和7年度)に、31万台出荷 (売上金額 約2.2億円) 現状) コロナ禍により客先での新製品の評価が遅延 年内サンプル出荷を目標
補助事業の効果	最終製品への取組内容と量産化対応 2022年(令和4年度) 新入社員1名入社



外観写真